

产品说明书

NC 506型 锡球贴装助焊剂

特点

- 适用于针栅阵列及标准球栅阵列封装的锡球贴装
- 在所有金属化表面上的可焊性极好
- 残余物无需清洗
- 可用印刷，浸渍及针转移等方法涂敷
- 提高BGA锡球贴装工艺的成品率
- 适用于无铅或者锡铅焊接

简介

NC 506 型锡球助焊剂是一种低粘度、具有触变性的免清洗助焊剂，用于把锡球焊到到基片上（BGA制造业）。在顽固性氧化的表面（例如镀镍表面）上进行焊接时，这种助焊剂特别有用；任何需要使用免清洗助焊剂来贴装锡球的场合，都可以使用。它可以用各种不同方法进行涂敷。

特性

特性	测试值	测试方法
助焊剂类型	ROL1	J-STD-004 (IPC-TM-650: 2.3.32 and 2.3.33)
典型粘度	320kcps	Brookfield HB DVII-CP (5rpm)
表面绝缘电阻 (欧姆, 清洗后)	合格(在85°C 和 85% RH的条件下 7天以后>109)	J-STD-004 (IPC-TM-650: 2.6.3.3 IPC-B-24)
典型酸度值	103mg KOH/g	滴定
典型粘着强度	250g	J-STD-005 (IPC-TM-650: 2.4.44)
保质期	6 个月 (-20°C to +5°C)	粘度变化或用显微镜检查

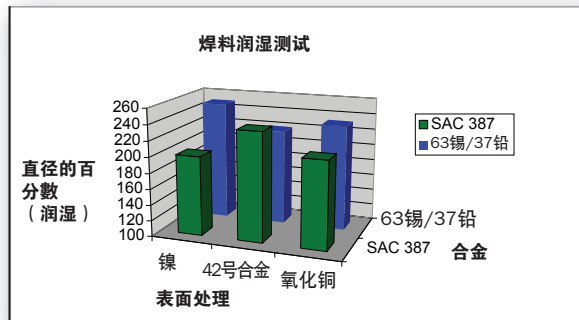
所有信息仅供参考。不用作未来产品的规范。

使用

可通过改变设备的参数实现针转移的最优化。针转移中的关键变量有针的形状和直径，剪切速度，停留时间及浸入深度。

清洗

NC506用于免清洗焊接。必要时，可用市面上买到的助焊剂清洗剂将它清除。请与Indium Corporation的技术服务工程师联系，他们会向您建议适合你的工艺要求的清洗剂。



包装

10-30克管装，100克罐装或筒装。还可根据具体要求提供其他规格的包装。

接反面→

Form No. 98243(SC A4) R0

焊料

INDIUM CORPORATION®

www.indium.com
china@indium.com
中国 +86 (0)512 628 34900
新加坡 +65 6268 8678
英国 +44 (0) 1908 580400
美国 +1 315 853 4900



经
ISO 9001
注册

NC 506型锡球贴装助焊剂

储存

管装及筒装NC506的存放温度为零下20°C至零上5°C，保质期可以达到最长。在超过25°C的环境里存放时间不可以超过4天。储藏温度不可以超过30°C。将NC506从冷藏条件下移到室温后，在使用前应在室温下放置至少4小时。

技术支持

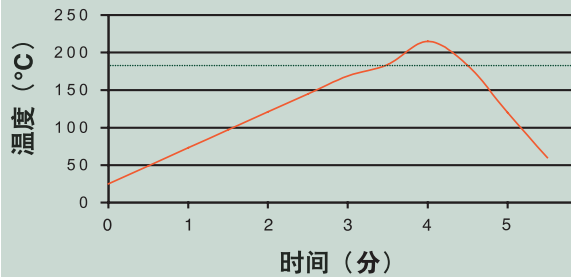
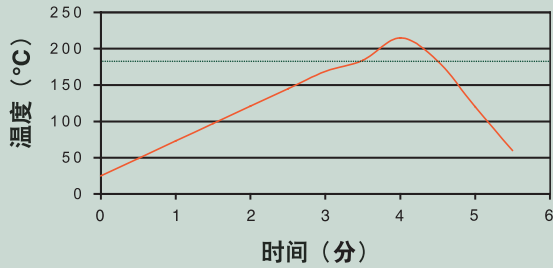
Indium Corporation 树立了为全球客户迅速提供现场技术支持的业界标准。Indium 公司的技术支持工程师队伍可提供材料科学和半导体封装工艺应用领域的各方面专业知识。

材料安全数据

关于本产品的材料安全数据 (MSDS), 请上网查阅, 网址: <http://www.indium.com/techlibrary/msds.php>

回流

推荐的工作曲线:



再流焊

在空气或氮气 (氧氣含量<500ppm) 中进行再流焊, 温度先直线上升到比液相线温度高30°C, 再流最高温度应 <260°C。我们建议用户从这些温度曲线开始, 根据自己的工艺要求对它进行优化。

此资料只是一般信息。不能保证或担保这些资料所述产品的性能, 也不可以把这些资料看作是对所述产品的保证或担

保。售出的产品只承诺随产品包装及发票所附的书面保证及有关的限制条件。

焊料

INDIUM CORPORATION®

www.indium.com
china@indium.com
中国 +86 (0)512 628 34900
新加坡 +65 6268 8678
英国 +44 (0) 1908 580400
美国 +1 315 853 4900



经
ISO 9001
注册